

参加募集 第47回エンジニアリングセラミックスセミナー

「(第三回) 半導体製造装置用材料として期待されているセラミックス」

近年、急速に発展したIT分野の一角を担う半導体産業は、一見、セラミックス構造材料とは無関係なように思われます。しかしながら、 Al_2O_3 、 AlN 、 Si_3N_4 、 SiC などの代表的な構造用セラミックスは、金属では実現できない優れた耐熱性、耐摩耗性、耐プラズマ性に加え、高熱伝導性を有しており、半導体製造装置、検査装置、およびエッチング装置を構成する材料の一つとして、着実にその需要を伸ばし、半導体産業に不可欠な材料としてその地位を確立しています。

第三回目となる本年度の講演会では、過去に盛況だった第一回・二回と同様に半導体製造装置とセラミックス製造の二つの分野から講師の方を招き、半導体製造装置に使用されているセラミックスの現状と、これからの高速・高精度化に対応するためのニーズについて講演をしていただくことになっております。普段の学会や講演会では、あまり得ることのできないヒントやアイデアを発見できると思います。セラミックス研究分野の方のみならず、多方面から多くの皆様のご参加を期待しております。

主催：日本セラミックス協会 エンジニアリングセラミックス部会

協賛：(予定) 応用物理学会, 日本物理学会, 日本化学会, 日本金属学会, 粉体粉末冶金協会, 耐火物技術協会

開催日：2015年12月16日(水) 13:30～

場所：東京工業大学 田町キャンパス キャンパス・イノベーションセンター 国際会議室
東京都港区芝浦 3-3-61

JR 田町駅芝浦口から徒歩1分 (URL: <http://www.cictokyo.jp/index.html>)

定員：100名(定員になり次第締め切ります)

参加費：会員 13,000円(協賛学協会を含む), 学生会員 6,000円, 非会員 15,000円
(申込時入会は会員扱)(消費税・テキスト代込)

申込方法：HP (http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html) の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー前日までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合先：〒169-0073 新宿区百人町2-22-17

公益社団法人日本セラミックス協会 エンジニアリングセラミックス部会

TEL: 03-3362-5231 FAX: 03-3362-5714

振込先：三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 (普) 0073211

(公社) 日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます。

プログラム

13:30～14:30 「半導体製造装置産業の技術開発動向と装置を構成するセラミックス部材への期待」

(東京エレクトロン宮城(株)) 佐藤直行

14:30～15:10 「セラミックスでヒートシンクの特性利用」

(西村陶業(株)) 西村元延

15:30～16:10 「半導体製造装置用合成石英ガラス(仮)」

(AGCエレクトロニクス(株)) 高田雅章

16:10～16:50 「エアロゾルデポジション法による半導体製造装置用部材の開発」

(TOTO(株)) 清原正勝